

技術詞彙

本技術詞彙載有本售股章程所用若干有關本公司及本公司業務之詞彙說明。該等詞彙及其涵義不一定與該等詞彙之標準行內涵義或用法相同。

「球柵陣列」	指	球柵陣列(ball grid array)
「線路板芯片貼裝」	指	連接集成電路與印刷線路板之鋁線接合
「軟板芯片貼裝」	指	突破縮小體積、減輕重量及減低電子產品複雜性之新開發LCD模組技術
「CD」	指	光碟
「DVD」	指	數碼多用途光碟，一種光碟儲存技術
「DIP」	指	雙排直插式組件
「電子製造服務」	指	電子製造服務(electronics manufacturing services)
「倒裝晶片」	指	一面具一排小型焊接「塊」之裝置，該等「小塊」用作接合芯片載體，一般直徑0.004吋，約為人類毛髮直徑之兩倍
「功能測試」	指	產品在功能上進行測試
「FPC」	指	軟性印刷線路，應用軟性物料及備有或不備軟蓋層之印刷線路型板
「FPHS」	指	精細熱壓技術，將LCD顯示連接至以線路板芯片貼裝或外部引線接合製成之印刷線路板之技術，可用於非常精細之接合
「GPS」	指	全球定位系統(global positioning system)
「集成電路」	指	集成電路(integrated circuit)
「ICT」	指	內部電路測試(in-circuit tester)
「LAN」	指	區域網絡
「LCD」	指	液晶顯示屏，用於電腦顯示屏及手錶等之技術
「主機板」	指	電腦主板

技術詞彙

「MP3」	指	容許CD曲目縮小至正常大小約十分一而不嚴重影響音質之數碼音樂制式
「MPEG」	指	移動圖像專家組
「原設計製造商」	指	原設計製造商
「原設備製造商」	指	原設備製造商
「印刷線路板」	指	印刷線路板，於其上貼裝電子之主機板，一般以銅包絕緣體製成，一或兩面以化學方式蝕刻電路，繼而鑽孔及將組件裝於孔上，及焊接至其他銅料
「PDA」	指	個人數碼助理，結合電腦、電話／傳真、互聯網及網絡功能之掌上裝置
「PIE」	指	生產及工業工程部
「RMA」	指	物料退回許可
「SMT」	指	表面貼裝技術組裝工程(surface mount technology)之英文簡稱，將元件直接焊接於印刷線路板板面之電路建構技術
「TAB」	指	帶式自動貼裝，建立電路片與基片間電力連接之方法，使用以單一工序大量貼裝於集成電路上之塊片之波束帶導體
「TFD-LCD」	指	薄膜二極管液晶顯示屏，為一種影像傳送技術，由玻璃或若干其他基片與二極管夾層組成。TFD顯示容許像素之二極管獨立啟動，並提供更高重新整理速度，影像重疊的情況亦較少
「TFT-LCD」	指	薄膜晶體管液晶顯示屏，每個個別像素均有獨立開關，容許電壓活躍供應至個別像素而非整行或整列像素同時接收電流，可提供更高影像對比度，且較舊式顯示屏大幅改善重新整理速度

技術詞彙

「USB」	指	通用串行總線(universal serial bus)之英文簡稱，為理論上可連接電腦與大量外接式設備之技術
「VGA」	指	視頻圖像陣列
「WCSP」	指	圓片級晶片封裝技術，容許組件精確地裝配於極細小矽片之先進焊接技術，容許電線直接於矽片底下由週邊鋁接觸片佈置成以陣列方式排列之焊球，故能大幅縮小矽片之體積、長度及重量，同時維持並改良傳統平盤式之可靠度